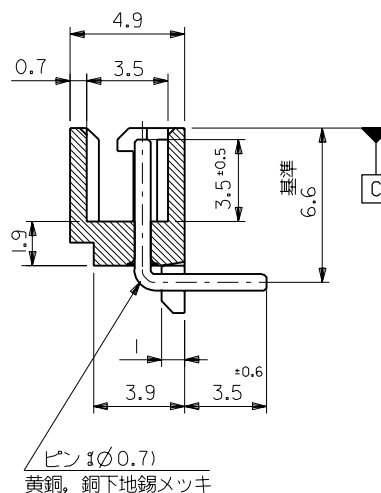


NOTE:

1. 嵌合相手：5264シリーズ




39.9	38.5	35	22-05-7155	5268-15A	15
37.4	36	32.5	↗ -7145	↗ -14A	14
34.9	33.5	30	↗ -7135	↗ -13A	13
32.4	31	27.5	-7125	-12A	12
29.9	28.5	25	-7115	-11A	11
27.4	26	22.5	-7105	-10A	10
24.9	23.5	20	-7095	-09A	9
22.4	21	17.5	-7085	-08A	8
19.9	18.5	15	-7075	-07A	7
17.4	16	12.5	-7065	-06A	6
14.9	13.5	10	-7055	-05A	5
12.4	11	7.5	↘ -7045	↘ -04A	4
9.9	8.5	5	↘ -7035	↘ -03A	3
7.4	6	2.5	22-05-7025	5268-02A	2
C	B	A	EDP NO.	ENG.NO.	極數

角度	ANGLE
30 以上	OVER
10 以上 30 未満	OVER UNDER
10 未満	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES

8						
25	C	再作図及び変更(J10590)	K-1	H,H	9/17/76	
記号		変更内容	DR		日付	
LTR		REVISION RECORD	CHK.		DATE	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM						

材料 MATERIAL		
仕上げ FINISH		
適用電線範囲 WIRE RANGE		
被覆外径 INS. RANGE		
DRAWN BY K.TOJO '91/7/26	CHK'D BY '92/08/31	
APP'D BY M.ENOMOTO '92/08/31	H.H 尺度 SCALE 5-1	

 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
EDP. NO.	
22-05-7**5	
ENG. NO.	REV
SD-5268-NA	C
TITLE 名称	
2.5 LOW PROFILE	
WAFER ASS'Y 90° BEND	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。